2018-2024年中国晶圆代工市场竞争态势及投资战略咨询研究报告

报告大纲

智研咨询
www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2018-2024年中国晶圆代工市场竞争态势及投资战略咨询研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chyxx.com/research/201803/624211.html

报告价格：电子版: 9800元　纸介版：9800元　电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联 系 人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

报告目录：

第一章半导体产业链
1.1半导体产业链
1.2晶圆制造
1.3晶圆成本分析
第二章半导体下游市场现状与未来
2.1手机市场
2.1.1国际智能手机行业发展历程
2.1.22017年全球智能手机消费市场规模
2.1.32017年全球智能手机品牌市场分析
2.1.4国际智能手机操作系统市场竞争态势
2.1.5世界智能手机市场快速扩张暗藏隐忧
2.1.6全球智能手机操作系统排行榜及市场占有率
2.1.72017年中国4G手机市场分析
2.1.82017年中国手机产量分析
2.2PC与平板电视市场
第三章半导体产业现状与未来
3.1半导体产业概况
3.2、全球半导体地域分布
3.3、晶圆代工
3.4、全球晶圆代工厂横向对比
3.5半导体设备与材料
第四章中国半导体市场与产业
4.1、中国半导体市场
1.产业环境
2.市场现状
4.2、中国半导体产业
4.3、中国晶圆代工及IC设计产业
第五章晶圆代工厂家研究（ZYZF）
5.1台积电
5.2联电
5.3GLOBALFOUNDRIES
5.4中芯国际

5.5DONGBU
5.6世界先进
5.7MAGNACHIP
5.8IBM微电子
5.10TOWERJAZZ
5.11X-FAB
5.12华润微电子
5.13三星电子（ZYZF）
图表目录：
图表12017年全球半导体厂商营业收入的最终排名表（百万美元）
图表22017年至2017年全球半导体设制造设备支出预测
图表3晶圆尺寸变化影响加工成本趋势分析
图表42018-2024年全球5大智能手机市场份额预测分析
图表52016年与2017年不同品牌手机销售情况分析
图表62016年与2017年全球智能手机不同操作系统手机销量对比分析
图表72018-2024年中国PC出货量分析
图表82017年全球半导体区域布局分析
图表92012年-2017年我国国内生产总值
图表102011年-2017年我国GDP同比增长速度
图表112017年主要工业产品产量及其增长速度
图表122017年规模以上工业企业实现利润及其增长速度单位:亿元
图表132010-2017年全部工业增加值及其增长速度
图表142017年分行业城镇固定资产投资及其增长速度
图表152017年城镇固定资产投资增长速度
图表162008-2017年全社会固定资产投资及增长速度
图表172017年分行业城镇固定资产投资及其增长速度
图表182017年我国固定资产投资情况
图表192017年各地区固定资产投资(不含农户)情况
图表202017年我国固定资产(不含农户)增速情况
图表212017年固定资产投资(不含农户)主要数据
更多图表见正文……

详细请访问：https://www.chyxx.com/research/201803/624211.html